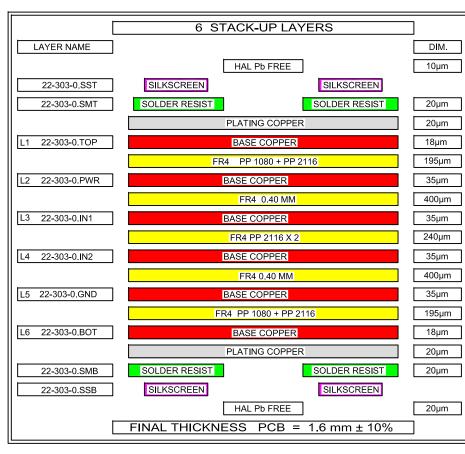


DRILL CHART				
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
×	0.200 mm		530	
_	0.900 mm		33	
⊠	1.100 mm		13	
₩	1.200 mm		2	
ъ	1.300 mm		6	
0	3,200 mm		5	
TOTAL			589	



## MATERIALE SUPPORTO SPESSORE RAME TIPOLOGIA CIRCUITO X LATI ESTERNI ☐ MONOFACCIA ∏ FR2 35u ☐ DOPPIA FACCIA X FR4 LATI INTERNI **M** MULTISTRATO SPESSORE SUPPORTO ALTRO N°LAYERS 1.6 mm TRATTAMENTI RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u PLACC.ELETT. SURFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u PLACC.ELETT. RIFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u RAME PASSIVATO MHOT AIR LEVELING □0.3u □0.6u □1,0u □1,3u □2,0u $\square$ DORATURA(D=140± $\vee$ PN) BISELLATURA NUMERO DEI CONTATTI DEPOSITO DI GRAFITE NUMERO DEI CONTATTI SOLDER RESIST **SERIGRAFIA** XLATO COMP.COLORE BIANCO SERIGRAFICO Sp. FOTOGRAFICO Sp. 13-100u XLATO SALD. COLORE BIANCO ☐ COVER LAYERSp. 25-76u TABELLA DEI FORI CON FILES DI DOCUMENTAZIONE LAVORAZ. PARTICOLARI ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE TIPO MET. N.MET. Q.TA' LAYER BOT **X** 22-303-0.BOT Α LAYER TOP **▼** 22-303-0.TOP **X** 22-303-0.PWR В LAYER PWR С **X** 22-303-0.GND LAYER GND D **X** 22-303-0.SSB SERIG. BOT Ε **X** 22-303-0..SST SERIG. TOP F **X** 22-303-0.IN1 LAYER IN1 X 22-303-0.IN2 LAYER IN2 G Н LAYER IN3 LAYER IN4

RESIST BOT

**PAST BOT** 

PAST TOP LAYER FOR.

DRILL TAPE

MECC.DRW.

X 22-303-0.SMB

X 22-303-0.SMT

**☒** 22-303-0.TAP

**X**PF22-303-0.DWG

LAYER FOR. 

☑
DRILL CHART 
☑
22-303-0.DRD



NOTE PARTICOLARI

TUTTI I FORI NON

INDICATI DEVONO ESSERE METALLIZATI

L

М